

FUJITSU PLM解决方案

良品解析事例（采用超音波探伤装置实施非破坏检查）

超音波探伤仪对观察微小缝隙及内部状态很有效

超音波探伤装置不仅可以看到IC内部的剥离状况，还可适用于多种材料构成的物态的确认。因此可以确认IC以外部品的剥离状况，有时可应用于目前X线无法透视观察的场合。

■解析事例

1.面板贴合状况



■面板的贴合部位
确认到粘结胶带的贴附位置处（黄色部位）没有问题

观察频率 100MHZ
左：观察结果 右：样品

2.散热片接合状态



■铝散热片的接合部位
确认到接合部位不均一（白色部分）

观察频率 30MHZ
左：观察结果 右：样品

3.压铸件内部状态



■压铸件产品的内部
确认到内部没有大的空巢

观察周波数 100MHZ
观察面积 □20mm
左：观察结果 右：样品

※同时可提供断面观察、成分解析服务。